

EOPROMFLEX®

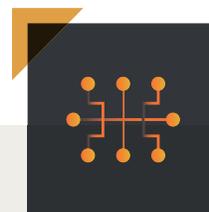
**SOLUTIONS INDUSTRIELLES POUR LE
SECTEUR DE L'ÉLECTRONIQUE IMPRIMÉE**



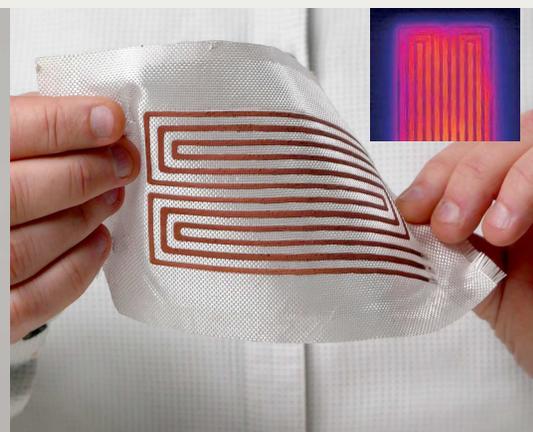
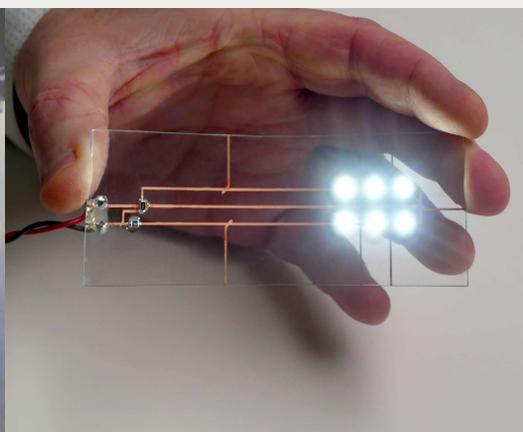
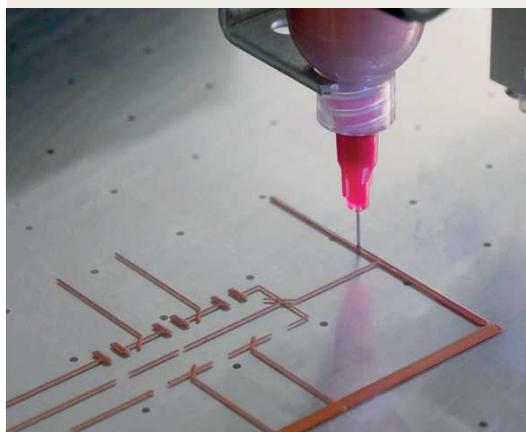
**Technologie
additive**



**Matériaux
flexibles**



**Métallisation
des plastiques
et composites**



PROCÉDÉ EN 3 ÉTAPES

01

DÉPÔT DE PÂTE EOPROM®

Impression / Sérigraphie
Pulvérisation / R2R



02

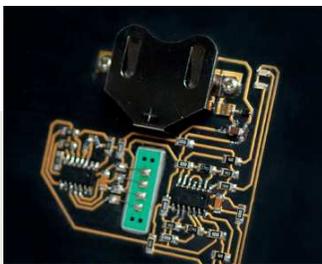
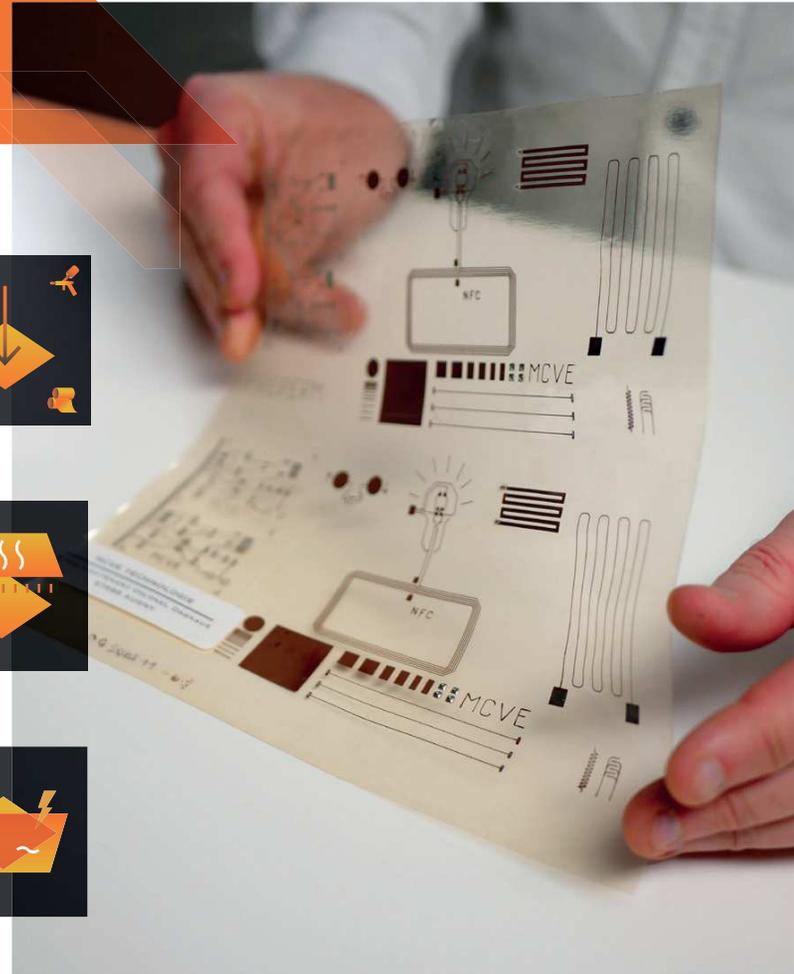
SÉCHAGE & RÉTICULATION



03

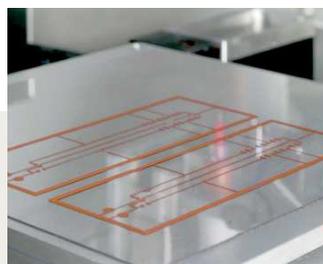
BAINS DE MÉTALLISATION

Cuivre electroless &
électrochimique,
Ni, Sn, Au



EOPROM® L'ADHÉRENCE

Une couche primaire utilisant une formulation à base de charges métalliques donne une force d'adhérence exceptionnelle sur de nombreux substrats. Le renfort métallique permet d'obtenir une gamme de conductivité étendue.



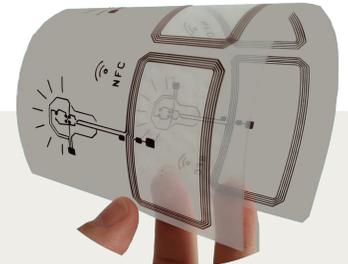
PROCÉDÉ À FAIBLE COÛT ET ÉCOLOGIQUE

Ce matériau est peu coûteux (à base de Cu). Le procédé est entièrement additif, avec un faible impact sur l'environnement, et conçu pour une production de masse pour un faible coût.



SUR PLASTIQUE ET COMPOSITE

Les dépôts sont possibles sur PC, PI, PET, PPE, ABS, PA, Corian®, FR4, fibre de verre, céramique, certains PP et quelques résines. Les préimprégnés de tissus de verre sont fonctionnalisés avant thermoformage.



FLEXIBLE ET MULTI-APPLICATION

La pâte EOPROM® se fixe sur des substrats souples ou rigides pour une large gamme d'applications :

- Circuit électronique
- Chauffage
- IMS
- Blindage EMI
- Antenne